

证券代码：001309

证券简称：德明利

深圳市德明利技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	前海开源基金、南方基金、同泰基金、长城基金、东方基金、湘财基金、云杉基金、华西基金、嘉恩资产、旌安投资、三花资产、昊晟投资、玖润投资、进化论资产、兴业证券、长江证券、中信建投、国泰君安证券
时间	2023年1月17日下午2:30-5:00
地点	深圳市福田区新一代产业园1栋A座25楼公司培训室
上市公司接待人员姓名	董事长 李虎 总经理兼董事会秘书 田华 董事长特别助理 徐中辅 董事长助理 梁颖
交流内容及具体问答记录	1、公司目前处在一个主要目标市场从移动存储切入嵌入式存储的关键阶段。从技术上说，相关的控制器主要是接口形态发生变化，公司过去的技术储备决定了做这样的关键转变是没有特别大的风险。这样的理解对吗？ 答：公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，积累了丰富的研发经验，目前公司开始布局嵌入式存储业务，从技术上来说，两部分业务都是基于对闪存的管理，有很多相似点。公司长期深耕闪存领域，相关技术积累和研发经验能够有效保障公司顺利完成两部分业务的技术承接和转换，帮助公司形成有竞争力的嵌入式存储产品，顺利完成业务布局规划。 尤其是今年我们计划投片的 eMMC 主控芯片在相应的基础协议、基础 IP、固件算法、相关框架上，跟 SD 是非常类似的，在 eMMC 的人才储备上，尤其在硬件设计和固件开发方面，和移动存储业务是有一定程度重叠的。但是有一些设计上的 IP 还是需要通过外购去加速实现流片。总体而言，在相应的自主研发的道路上，我们是具有足以完成战略目标的技术和研发储备的。 2、看到 2023 年会发 SATA SSD 的控制器芯片，有没有预计芯片流片回来测试 OK，产品盈利的节奏？ 答：根据目前的研发情况，我们预计 2023 年二季度会进行一颗 SATA 固态硬盘主控芯片的 tape-out，最终导入产品的时间节点要看后续的测试效果，如芯片的性能指标、适配性等，同时公司在进行研发方案规划时也充分沟通并考虑了存储原厂未来几年的技术路径，尽可能提高公司主

	控芯片对未来存储晶圆的适配性。公司目前研发进展顺利，有信心完成相关芯片的研发和量产推广。 3、基于公司在使用自研控制器的同时，不拒绝使用外购控制器，为什么公司前期在做 Partial Wafer 产品时，没有在 Normal Wafer 产品上特别发力，比如固态硬盘、eMMC、UFS 之类？ 答：公司遵循商业逻辑进行战略规划，根据公司不同发展阶段进行业务布局。行业级固态硬盘和嵌入式存储产品等业务对资金规模、人员配备和技术能力等都有较高的要求，尤其是主控芯片的研发需要比较深厚的技术沉淀。公司一直以来通过自研主控芯片导入产品的方式形成竞争优势，前期发展阶段广泛布局上述业务不利于公司资源聚焦，也会给经营带来比较大的压力，因此公司前期主要是聚焦移动存储领域。目前，随着公司业务规模的不断增长，技术积累日益丰富，公司综合实力较前期已有较大幅度提升，在业务上开始布局行业级固态硬盘和嵌入式存储业务，并开展相关业务领域的主控芯片研发。 4、未来产品会有哪些产品放在 UDS 平台上，会有哪些产品不用这个平台，用现在的？ 答：UDStore 这个品牌主要是以面向商业应用、工业应用、车载应用为主，并且是以采用 Normal Wafer 存储晶圆作为适配基础的一个方案组成。只要是在行业应用场景上，需要相应比较高的寿命，比较严格的质量要求，基本上都是 UDStore 品牌旗下的产品。这是德明利整个产品布局里面，针对嵌入式和行业存储的一个板块。在消费类存储，包括移动存储、消费类 SSD，有一些存储品牌客户或面对终端消费者的集成商、通路商客户的，我们就不使用品牌直接向他们销售模组。 5、2023 年会有 3 颗 tape out 的主控芯片，像 Emmc 和 SATA SSD 的，我们流片的芯片算上验证周期等可能要明年适配产品，今年实际上会用第三方控制器做相关的产品吗，会影响我们推广相关产品吗？ 答：在我们流片没出来之前，肯定要用第三方的，就像最早的卡盘产品，这样公司体量上来后，导入自研主控芯片的时间点就刚好。我们自研主控芯片的流片进度不影响整体产品的出货/交付，只是自研主控出来后，我们的竞争能力会进一步提升。 6、公司需要较长时间向晶圆厂订货，上游供应端能支持多少业务增量？ 答：存储晶圆在目前市场的下行阶段，各位从其他上游的公开信息都会看到，不管是美光、三星、WD、铠侠，他们自己本身现在的库存水位，最少的有 5 个月，最高的有 7 个半月，对于我们战略合作的这些上游芯片供应商来说，这些库存是他们接下来积极去化的主要任务。所以对我们而言，在目前整个协商采购的过程当中，其实交期都是相对很短的。我们在供应链上游的资源布局上，已经着眼在第二季度相应的规划，所以在交期和预定的层面上，应该是不存在太大的问题。
--	---

7、2023 年公司计划投产 3 颗主控芯片，分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式，哪一颗是重点？

答：总的来说三者都是重点，存储卡一直是我们公司的主要产品也是基本盘，固态硬盘和嵌入式产品是公司未来的重点发展方向，因此我们对应布局了这 3 个主控芯片的研发。我们已经根据 3 颗芯片的研发目标制定了相应的研发计划并配备相应的研发资源。我们都是按照原厂 Nand Flash 技术的中长期迭代演变规划进行的同步研发布局。

8、21 年公司自研主控占比提升很多，但是毛利率下滑。自研芯片占比提升降本，为什么没有体现降本效果？

答：2021 年公司毛利率小幅下滑，主要是行业因素导致的，相比而言公司的毛利率下降幅度相对较小。虽然我们大幅提高了自主控制器适配的比例，递减了部分行业价格变动因素的影响，但毛利率仍呈现小幅下滑的情况。

9、自研芯片与外购芯片的成本差异有多少？

答：各类型主控芯片不完全一致，但自研肯定会有一定的成本优势。

10、大容量产品需要的主控芯片数量会增加么？

答：一般而言，无论容量多大，一个存储模组都会搭配一颗主控芯片。

11、下游行业中，服务器、PC 进展如何？

答：对公司来说，服务器和 PC 系从某种程度上是同一类型的存储市场。在这些业务板块里面，大部分原厂的产品线，比如三星、美光自己本身的 SSD，基本上会占有比较大的份额，第三方模组厂则会占一个相对较小的比例。我们跟几个头部客户都在密集地磋商和导入。如进展顺利预计在今年下半年服务器和 PC 都会有一些实现量产的项目机会。

12、手机客户今年是否有突破？

答：手机产品是主要使用 eMMC 和 UFS 嵌入式产品的。这类产品的客户在验证上都会需要一定的时间，大概 3-6 个月，再加上过去这一年，其实很多手机客户不断在下修库存，所以预计我们会优先在产品验证端尝试布局一些主要客户。

13、公司后续会在服务器，汽车、PC、笔电、平板、手机等领域布局吗？

答：公司已经在逐步布局这些行业市场，目前业务基数较低，未来行业扩展也是个循序渐进的过程。存储行业上市公司相对较少，公司作为行业内上市公司，在资金、人员和平台等方面具有一定的先发优势，且已经初步搭建了相应的运营、研发和销售体系，相信未来会形成相应的市场份额。

14、请介绍一下公司后续的团队扩充规划？

答：2022 年公司新设了成都研发中心，公司目前研发团队人员约 150 人，

后续公司会进一步扩充团队，尤其是固态硬盘业务、嵌入式存储业务相关的运营团队和研发人员。

15、请问张汝京任职公司独董的渊源？

答：张博士是中国集成电路行业的先驱者和奠基者，很关注中国集成电路事业的发展，也是一个愿意帮助和提携后辈的行业大师。我们公司早期是在台湾做研发，后来转移到大陆，在台湾时候就跟张博士有认识，交流了很多集成电路行业发展的想法，也得到了张博士的指导，所以我们也聘请张博士做我们的独立董事，主要是帮助确定公司的长期战略规划。

16、为何公司会受到国外投资机构的关注？

答：这些机构目前和公司还没有接触和沟通，这些应该是市场判断选择的结果，具体公司不清楚。

17、近期国内机构对公司的关注度高吗？

答：近期国内机构的调研需要比较多，表明市场对公司的关注度还是比较高的，公司也是充分考虑投资者的这些需求，尽早安排交流会，这次在年前这么赶的时间内安排一个交流会也是一个体现。公司后续也会积极开展与投资者的沟通交流，向市场充分传递公司的未来发展规划等信息。

18、公司是否有股权激励计划？

答：公司是技术型企业，已经对部分核心员工进行股权激励，未来随着团队的扩充，还会继续进行股权激励，这也符合技术型行业的一般特点。

19、公司认为存储器价格什么时候有望见底，今年会出现拐点吗？

答：这个问题比较仁者见仁，智者见智。行业普遍存在一种预判，很多投资机构也有预测，上半年半导体的上游产能利用率大概会触底，台积电跟联电在近日举办的法说会也有相关说明。我们从行业惯性来看，在主芯片得到相应的去化之后，存储器将迎来机会。所以我们按照这样的市场研判，2023年下半年存储行业出现底部的可能性比较大。

20、公司存储卡、固态硬盘、存储盘模组的业务区别？哪块业务增速比较快？

答：存储卡盘和消费类固态硬盘主要是用 Partial Wafer，高端固态硬盘主要是用 Normal wafer，原材料存储颗粒的品质存在差异，固态硬盘一般比存储卡盘的存储颗粒品质要求高。未来固态硬盘业务的增长潜力更大。

21、请问公司认为短期和中期的主要业绩驱动因素是什么？

答：短期来看，公司业绩主要受产品毛利率影响比较大，目前有市场声音判断未来可能迎来行业周期拐点，进而影响行业整体毛利率，公司对2023年持乐观态度。中期来看，公司业绩驱动主要来自核心竞争力驱动下的产品线不断拓展带来的规模扩张，与自研主控产品渗透率提高带来

	的毛利提升，前者主要为 SSD 模组与嵌入式产品拓展，后者包括存储卡自研主控持续迭代升级与 SSD 自研主控的量产与导入。 22、公司自研主控芯片与市场上主流的主控芯片的区别？ 答：公司的移动存储管理应用方案，是以主控芯片、固件方案及量产工具程序相结合的方式。公司自研主控与市场主流主控的区别主要有：（1）公司持续加大研发投入，采用先进制程实现主控芯片的持续更新迭代，确保自研主控芯片性能保持行业先进水平；（2）公司根据市场上主流 NAND Flash 的性能，对固件方案和量产工具做了定向优化，且针对式的依据 NAND Flash 的性能对主控芯片进行开发，形成高效的存储管理方案，有效提高了公司对存储晶圆的管理利用效率和产品稳定性，公司整体生产成本亦有大幅降低。 23、公司正在大力拓展行业客户，请问这些行业客户包含哪些头部企业？请问公司如何保证包括 SSD、嵌入式等在内的新业务顺利拓展？ 答：首先，公司在行业深耕多年，经营规模增长也比较快，积累了丰富的渠道资源和市场开拓经验，尤其是 2022 年以来公司根据发展战略，进一步针对行业市场搭建和完善了销售渠道和销售团队，积极布局高端固态硬盘和嵌入式存储市场，大力拓展通讯及手机领域、汽车电子领域、数据中心领域等行业客户，公司从组织架构上也新设了迅凯通和富洲承等子公司，专门负责对接行业市场 and 海外市场的销售和拓展，部分行业客户的验证和产品导入已在逐步开展，未来会在经营业绩中逐步体现和释放。基于我们与很多客户合作的保密性要求，我们这次沟通不对个别客户的合作情况做特别说明和回复。其次，公司的差异化路线决定了产品本身是具有优势与竞争力的，公司技术平台的快速研发能力及优异的存储晶圆利用率，使得公司存储产品在同一容量、读写速度等参数要求下具有较强的市场竞争力，未来随着公司智能制造存储产品产业基地的交付，公司的生产成本将进一步下降，从而进一步提升公司的竞争能力。最后，公司部分过往合作的下游客户本身也存在相关业务板块，基于过往合作信任，也便于公司新业务的导入。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无